

国泰海通证券股份有限公司
关于锦州神工半导体股份有限公司
2025 年半年度持续督导跟踪报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“神工股份”和“公司”）持续督导工作的保荐机构，负责神工股份上市后的持续督导工作，并出具本 2025 年半年度持续督导跟踪报告。本持续督导半年度跟踪报告释义与公司 2025 年半年度报告一致。

一、持续督导工作情况

项目	工作内容
1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。	保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持续督导工作。
2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期间的权利义务签订持续督导协议。	保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务。
3、协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。	保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和上市规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员、核心技术人员知晓其在上市规则下的各项义务。
4、持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。	保荐机构已持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。

项目	工作内容
5、对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。	保荐机构已对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
6、督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	保荐机构已督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。
7、上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、上市规则以及上海证券交易所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	本持续督导期间，上市公司及控股股东、实际控制人等不存在未履行承诺的情况。上市公司或其控股股东、实际控制人已对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。
8、督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐机构已督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
9、持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项，核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。	保荐机构已持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况。本持续督导期间，上市公司不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
10、重点关注上市公司是否存在如下事项： （一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上交所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。出现上述情形的，保荐机构及其保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起 15 日内按规定进行专项现场核查，并在现场核查结束后 15 个交易日内披露现场核查报告。	本持续督导期内，上市公司未出现该等事項。

项目	工作内容
11、关注上市公司股票交易严重异常波动情况，督促上市公司及时按照上市规则履行信息披露义务。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
12、上市公司日常经营出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司经营的影响以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）主要业务停滞或出现可能导致主要业务停滞的重大风险事件；（二）资产被查封、扣押或冻结；（三）未能清偿到期债务；（四）控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；（五）涉及关联交易、为他人提供担保等重大事项；（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
13、上市公司业务和技术出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对公司核心竞争力和日常经营的影响，以及是否存在其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）主要原材料供应或者产品销售出现重大不利变化；（二）核心技术人员离职；（三）核心知识产权、特许经营权或者核心技术许可丧失、不能续期或者出现重大纠纷；（四）主要产品研发失败；（五）核心竞争力丧失竞争优势或者市场出现具有明显优势的竞争者；（六）交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
14、控股股东、实际控制人及其一致行动人出现下列情形的，保荐机构、保荐代表人应当就相关事项对上市公司控制权稳定和日常经营的影响、是否存在侵害上市公司利益的情形以及其他未披露重大风险发表意见并披露：（一）所持上市公司股份被司法冻结；（二）质押上市公司股份比例超过所持股份 80%或者被强制平仓的；（三）上交所或者保荐机构认为应当发表意见的其他情形。	本持续督导期间，上市公司及相关主体未出现该等事项。
15、督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	保荐机构已督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。

项目	工作内容
16、持续关注上市公司建立募集资金专户存储制度与执行情况、募集资金使用情况、投资项目的实施等承诺事项，对募集资金存放与使用情况进行现场检查。	保荐机构对上市公司募集资金的专户存储、募集资金的使用以及投资项目的实施等承诺事项进行了持续关注，督导公司执行募集资金专户存储制度及募集资金监管协议，于 2025 年 7 月 29 日至 2025 年 7 月 30 日对上市公司募集资金存放与使用情况进行现场检查。
17、保荐机构发表核查意见情况。	2025 年上半年，保荐机构发表核查意见具体情况如下：2025 年 3 月 27 日，保荐机构发表《国泰君安证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》；2025 年 5 月 30 日，保荐机构发表《国泰海通证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见》。
18、保荐机构发现的问题及整改情况（如有）	不适用。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）客户集中风险

大直径硅材料产品是公司收入的主要来源。单晶硅材料行业具有进入门槛高、细分行业市场参与者较少等典型特征。公司主要客户包括三菱材料、SK 化学等境内外企业，主要分布在中国、韩国、日本等国家和地区，客户集中度较高，存在客户集中风险。如公司下游主要客户的经营状况或业务结构发生重大变化并在未来减少对公司产品的采购，或出现主要客户流失的情形，公司经营业绩存在下滑的风险。

（二）供应商集中风险

公司生产用原材料主要为高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚和石墨件等，其中高纯度多晶硅的终端供应商主要为瓦克化学，高纯度石英坩埚的主要供应商为

SUMCOJSQ, 尽管公司已经开始根据下游客户需求进行原材料国产化, 但公司高纯度多晶硅和高纯度石英坩埚的采购渠道仍较为单一, 采购集中度较高。如果公司主要供应商交付能力下降, 公司原材料供应的稳定性、及时性和价格均可能发生不利变化, 从而对公司的生产经营产生不利影响。

(三) 原材料价格波动风险

公司生产用主要原材料为高纯度多晶硅、高纯度石英坩埚和石墨件等, 原材料成本占公司主营业务成本的比重较高, 主要原材料价格的变化直接影响公司的利润水平。如果未来原材料价格大幅度上涨, 且公司主要产品销售价格不能同步上调, 将对公司的盈利能力产生不利影响。

同时公司采购的多晶硅原材料纯度通常为 8 个 9 以上, 公司生产并销售的集成电路刻蚀用单晶硅材料产品纯度主要为 10 个 9 以上。纯度是公司产品的重要参数指标之一, 从纯度参数看公司产品与原材料的纯度差异较小, 约为 1-2 个数量级; 如果公司采购的原材料质量不稳定, 可能对公司产品品质产生一定不利影响。

(四) 业务波动及下滑风险

公司的大直径硅材料产品主要向下游集成电路刻蚀用零部件制造商销售。此类制造商对公司产品进行精密机械加工形成硅零部件产品, 最终销售给等离子刻蚀机制造商或直接向集成电路制造厂商销售。

部分规模较大的硅零部件生产商除具备机械加工能力外, 仍自行保有一定规模的大直径单晶硅材料生产能力。在行业上升周期, 主要客户对单晶硅材料的增量需求主要通过外购满足, 而在行业下行周期, 主要客户因具备一定的大直径单晶硅材料生产能力, 外购单晶硅材料的规模可能下降。因此, 公司作为行业内主要的大直径单晶硅材料生产企业, 在行业下行周期中可能面临较高的业务波动风险。

同时, 报告期内公司产品主要向中国大陆、日本、韩国销售, 半导体国产化进程及全球半导体产业景气恢复对公司业绩带来一定积极影响, 但公司下游客户

采购计划的调整相比行业景气度恢复具有一定的滞后性，且半导体行业属于周期性行业，行业整体需求受全球地缘政治冲突等影响仍存在不确定性。

公司硅零部件和半导体大尺寸硅片产品，面向半导体等离子刻蚀机设备厂商和集成电路制造商销售。考虑到半导体行业景气度通过影响存量芯片生产线的产能利用率以及芯片生产线的新增投资水平，最终影响等离子刻蚀机硅零部件产品和半导体大尺寸硅片市场需求，因此公司以上两种新产品的销售前景与半导体行业景气度相关，在行业下行周期中同样可能面临一定的业务波动风险。

（五）市场开拓及竞争风险

公司大直径硅材料产品的现有客户包括三菱材料、SK 化学、CoorsTek、Hana 等半导体材料行业企业；硅零部件产品下游客户为国内等离子刻蚀机制造厂商和国内集成电路制造厂商，前者如北方华创、中微公司，后者如长江存储、福建晋华等公司；半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片的目标客户群体为国内外集成电路制造商，主要包括台湾积体电路制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司等企业。因此，公司大直径硅材料产品既有客户与硅零部件产品、半导体大尺寸硅片产品的目标客户并不重叠，公司拓展下游客户存在一定难度和不确定性；同时半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片所在细分市场的市场集中度较高，新进入者面临的市场竞争较为激烈。

如果公司不能成功开发半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片或开发进度不及预期，则可能拉长前期技术投入的回报期或无法有效应对市场竞争，将会对公司未来经营业绩产生不利影响。

（六）毛利率下滑的风险

近年来下游市场需求和行业竞争格局不断变化，未来随着公司刻蚀用多晶硅材料销售规模的扩大以及募投项目建成后新增设备折旧的计提，若公司不能持续推出具有市场竞争力的优质产品，并通过提高生产效率、技术创新、规模效应等方式降低生产成本，则可能面临大直径硅材料业务毛利率下滑的风险。

（七）行业风险

半导体行业属于周期性行业，行业增速与科技发展、全球经济形势高度相关。此外，半导体行业的周期性还受技术升级、市场结构变化、应用领域升级、自身库存变化等因素的影响。近年来，半导体行业研发周期不断缩短，新技术、新工艺的不断应用导致半导体产品的生命周期不断缩短，对公司的技术优势产生影响。

2025 年，中美贸易摩擦仍然存在，全球性公共安全危机仍在对半导体产业链生产端造成负面影响，加之全球地缘政治军事冲突爆发等因素推高全球通胀水平，消费者信心受挫导致下游终端需求萎缩，全球半导体行业目前处于调整期。未来若中美贸易摩擦进一步升级、半导体产业景气度下滑，公司的生产运营可能受到影响。

（八）宏观环境风险

全球范围内主要等离子刻蚀机生产厂商和刻蚀用硅电极制造厂商位于日本、韩国和美国，公司大直径硅材料产品亦主要出口上述国家，公司海外销售比例较高。如未来相关国家在贸易政策、关税等方面对我国设置壁垒或汇率发生不利变化，且公司不能采取有效措施降低成本、提升产品竞争力，将导致公司产品失去竞争优势，从而对公司经营业绩产生不利影响。

（九）其他重大风险

1、募集资金投资项目建设风险

公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”涉及土建及机电工程、设备采购、设备安装调试等环节。前述募集资金投资项目在实施过程中可能受到工程施工进度、工程管理、设备采购、设备调试及人员配置等因素的影响，项目实施进度存在一定的不确定性，募集资金投资项目存在不能按期竣工投产的风险。

2、新增折旧摊销影响公司盈利能力风险

根据公司募集资金使用计划，募集资金投资项目建成后，公司资产规模将有所增加，从而导致公司年折旧及摊销成本费用增加。若募集资金投资项目不能较快产生效益以弥补新增固定资产和无形资产投资带来的折旧和摊销，将在一定程度上影响公司净利润和净资产收益率水平。

除上述因素外，公司不存在其他重大风险事项。

四、重大违规事项

2025 年上半年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2025 年上半年，公司主要财务数据及指标如下所示：

主要会计数据	2025 年上半年	上年同期	增减变动幅度（%）
营业收入（元）	208,527,693.79	125,219,876.76	66.53
利润总额（元）	63,849,458.17	6,483,746.44	884.76
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,837,928.66	4,762,100.10	925.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	47,989,908.96	3,893,909.04	1,132.44
经营活动产生的现金流量净额（元）	67,507,435.15	78,368,987.09	-13.86
主要会计数据	2025 年 6 月末	上年度末	增减变动幅度（%）
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,829,283,160.03	1,792,961,454.97	2.03
总资产（元）	2,037,769,388.31	1,992,903,335.46	2.25

主要财务指标	2025 年上半年	上年同期	增减变动幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.29	0.03	866.67
稀释每股收益（元/股）	0.29	0.03	866.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.28	0.02	1,300.00
加权平均净资产收益率（%）	2.69	0.27	2.42
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.64	0.22	2.42
研发投入占营业收入的比例（%）	5.38	9.84	-4.46

上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

受益于半导体行业周期回暖，公司订单增加，营业收入同比增加 66.53%，归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同步有所增长。经营活动产生的现金流量净额同比减少 13.86%，主要系本期较上期收到的政府补助减少所致。

综上，公司 2025 年上半年主要财务数据及指标变动具备合理性。

六、核心竞争力的变化情况

（一）技术优势

自成立以来，公司一直专注于大直径硅材料及其应用产品的研发、生产与销售，突破并优化了多项关键技术，构建了较高的技术壁垒。公司凭借无磁场大直径单晶硅制造技术、固液共存界面控制技术、热场尺寸优化工艺等多项业内领先的工艺或技术，在维持较高良率和参数一致性水平的基础上有效降低了单位生产成本。报告期内，公司在硅片技术领域研发取得了“8 英寸硅片研磨过程中的 TTV 控制技术”，可以减少厚度偏差控制研磨速率，实现对 TTV 的有效控制。

（二）质量优势

目前公司已经建立符合国际标准的质量控制和品质保证体系，并严格按照 ISO9001 质量管理体系认证的相关标准，在产品的设计开发、原材料采购、产品生产、出入库检验、销售服务等过程中严格实施标准化管理和控制，实施精益生产，使产品质量得到巩固和提升。公司持续通过艰苦的努力，规范和提高生产各个环节的标准化。

（三）客户优势

公司下游客户对合格供应商的认证程序十分严格，认证周期较长，认证程序复杂。凭借较高良品率和参数一致性水平、持续稳定的产品供应能力，公司在集成电路刻蚀用的大直径硅材料领域树立了良好的口碑，并与海外客户建立了稳固的商业合作伙伴关系。公司产品直接销售给日本、韩国等半导体强国的知名硅零部件厂商。后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备原厂，例如美国泛林集团（Lam

Research) 和日本东电电子 (Tokyo Electron Limited, TEL), 并最终销售给三星和台积电等国际知名集成电路制造厂商。公司硅零部件产品已经进入北方华创、中微公司等中国本土等离子刻蚀机制造厂商和长江存储、福建晋华等本土一流存储类集成电路制造厂商。

(四) 销售服务优势

公司建立了覆盖海内外的系统销售服务体系, 持续完善覆盖日本、韩国客户的服务网络, 并建立了兼具广度和深度的国内销售网络, 覆盖了国内主流刻蚀机原厂以及行业主流集成电路制造厂商, 能够提供及时可靠的售前和售后服务。

公司成立了由管理层负责的专业销售团队。通过定期及不定期拜访客户, 能够快速、准确地理解客户的个性化需求, 并及时获取行业技术发展动态及市场信息。公司在客户需求的响应速度、产品供货速度、持续服务能力等方面均表现良好, 形成了销售服务优势。

目前, 公司泉州、锦州两处硅零部件工厂按需扩产, 公司南北两处厂区的布局能够高效完成研发对接, 快速响应下游国内等离子刻蚀机生产厂家以及集成电路制造厂商客户自主委托定制改进硅零部件的需求, 更好地服务全国客户。

(五) 细分行业领先优势

公司自成立以来一直专注于大直径硅材料及其应用产品的生产、研发及销售。凭借多年的积累和布局, 公司在大直径硅材料领域继续保持领先地位, 掌握了 22 英寸及以下尺寸晶体的所有技术工艺, 能够大规模、高品质、高可靠、广覆盖地向全球下游厂商提供大直径硅材料产品, 在全球细分领域处于领先地位。

2018 年以来, 公司顺应了等离子刻蚀机技术升级所带来的新需求, 突破了大直径硅材料领域的诸多技术障碍, 长期的品质一致性和成本优势为公司赢得了国际市场份额, 并使下游客户对公司产生依赖。

近年来, 公司在 16 英寸以上大直径硅材料领域的产能扩张较快, 已经确保公司产能大于下游厂商的自有大直径硅材料产能, 具有技术和规模双重优势。由于公司下游直接客户硅零部件产品的主要应用场景在于终端客户集成电路制造

厂商的 12 英寸生产线，而 12 英寸晶圆制造越来越多地采用 16 英寸以上大直径硅材料产品所制成的硅零部件，因此公司具备独特的竞争优势。

在硅零部件领域，公司是国内极少数具备“从晶体生长到硅电极成品”完整制造能力的一体化厂商。公司硅零部件产品的上游原材料（大直径刻蚀用单晶硅材料）具备稳定性、一致性、便捷性及成本的优势。

综上所述，2025 年上半年，公司核心竞争力未发生不利变化。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

2025 年上半年公司研发费用为 1,122.06 万元，较上年同期减少 8.91%。2025 年上半年公司研发投入占营业收入的比例为 5.38%，较上年同期减少 4.46 个百分点。公司研发支出未发生明显不利变化。

（二）研发成果

2025 年上半年，公司在硅片技术领域研发取得了“8 英寸硅片研磨过程中的 TTV 控制技术”，可以减少厚度偏差控制研磨速率，实现对 TTV 的有效控制。新增发明专利申请 1 个，实用新型专利申请 4 个，软件著作权申请 2 个；获得实用新型专利 2 个，获得软件著作权 2 个。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

公司于 2023 年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许[2023]2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 10,305,736 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 29.11 元，募集资金总额为人民币 299,999,974.96 元，扣除不含税的

发行费用人民币 3,943,396.22 元后，实际募集资金净额为人民币 296,056,578.74 元。上述资金已全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 9 月 15 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]110Z0012 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金本期使用金额及年末余额

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计用于募投项目支出 16,460.16 万元。公司募集资金实际结余金额为 1,547.80 万元。募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户余额
招商银行锦州分行营业部	416900037710703	15,477,959.10
中国工商银行股份有限公司锦州桥西支行	0708004329200669624	已注销，零余额

公司 2025 年上半年募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金管理和使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2025 年上半年，公司主要股东更多亮照明有限公司、矽康半导体科技（上海）有限公司持股情况如下：

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	期末持股比例	变动原因
更多亮照明有限公司	0	37,003,560	21.73%	不适用
矽康半导体科技（上海）有限公司	0	35,550,301	20.87%	不适用

截至 2025 年 6 月 30 日，公司现任董事、高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况。

2025 年上半年，公司主要股东持有的股份均不存在质押、冻结的情形。

十一、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告或应当发表意见的其他事项

无。

十二、其他说明

本报告不构成对上市公司的任何投资建议，保荐机构提醒投资者认真阅读上市公司审计报告、年度报告等信息披露文件。

（本页无正文，为《国泰海通证券股份有限公司关于锦州神工半导体股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

姚巍巍

姚巍巍

陈海

陈海



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 9 月 // 日